

T303 奈米複合導熱墊片

產品描述：

本奈米導熱墊片是由奈米碳管 MWCNT、奈米 Ag、AlN、ZnO 及表面頓化的 Al 鋁粉組成，並與矽橡膠混合壓製成片，擁有高熱導、低熱阻優異性能，超薄、柔軟又耐壓，可提供發熱元件與冷卻元件間的傳導路徑，有效散熱。

應用範圍：適用在LED照明、各種電子及電器零組件之散熱。

儲存方式：請放置於乾燥陰暗的地方，可保存兩年。

使用方式：請裁減適當大小與尺寸，撕掉保護膜，平貼放置於要發熱元件表面

規格：

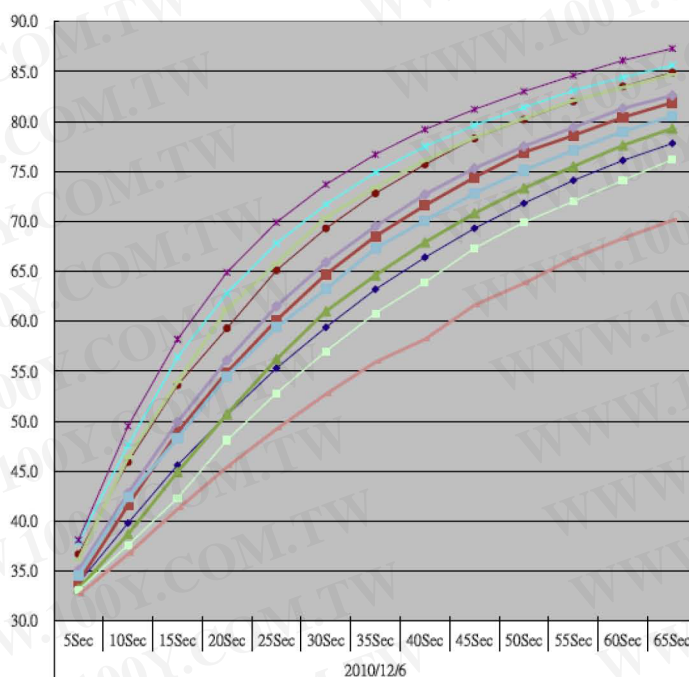
顏色形狀	灰黑色片狀
厚度	0.15 mm
比重(g/mL)	1.7 +/- 0.1
表面電阻率(Ω /sq)	<1014
導熱係數(W/m · K)	5.0 +/- 0.2
熱阻值(K · in ² /W)	0.17~0.19
使用溫度範圍(°C)	-40~150

備註 1：

導熱係數在重量=10Kg、
熱源=10W、厚度=0.15mm
下量測而得

備註 2：

本產品符合 RoHS 規定



導熱墊片測試

2010/12/6